

スパッタ 成膜ユニット

【特徴】

- マグネトロンスパッタ源と基板回転機構を装備
- すぐれた膜厚分布を実現
- DCスパッタリング、RFスパッタリングを切り替えて使用可能
- 2種類のスパッタ源を搭載することにより異なった膜種を成膜可能
- 逆スパッタ機能搭載により、基板のクリーニング&エッチングが可能
- ツーモーションシャッター採用によりコンタミおよび発塵を防止



【仕様】

- 処理基板： $\phi 300\text{mm}$
- 膜厚分布： $\pm 3\%$ ($\phi 300\text{mm}$)
- T S 間距離：50~90mm (半固定方式)
- スパッタターゲット寸法： $\phi 50\text{mm}$ 、 $\phi 100\text{mm}$ 各1
- スパッタ出力：500W+2kW
- 使用ガス：Ar、O₂、N₂